

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海硅产业集团股份有限公司

### 2021 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”、“公司”或“发行人”）持续督导的保荐机构，负责沪硅产业上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。2021 年上半年，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2021 年上半年，保荐机构通过日常沟通、不定期回访等方式，对公司开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021 年上半年，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	2021 年上半年，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，2021 年上半年，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相

		关法律法规的要求,并切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了公司治理制度建立与执行情况,《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求,2021年上半年,公司有效执行了相关治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	核查了公司内控制度建立与执行情况,公司内控制度符合相关法规要求,2021年上半年,公司有效执行了相关内控制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况”
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况”
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2021年上半年,公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,保荐人应及时向上海证券交易所报告	2021年上半年,公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2021年上半年,公司未出现该等事项
15	在持续督导期间发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上	2021年上半年,公司及相关主体未出现该等事项



	海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2021年上半年度，公司未出现该等事项
17	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项	保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议

## 二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对公司 2021 年上半年的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，沪硅产业严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

#### （一）300mm 大硅片业务尚未盈利的风险

报告期内，公司 300mm 大硅片业务在产量和出货量上有了较大幅度的提高，但由于前期巨大的固定资产投入和研发投入，仍未实现盈利。虽然如此，该业务的毛利率、EBITDA 利润率、净利率均获得了较大幅度的提升，为公司的经营业绩改善打下良好基础。

#### （二）技术研发持续性的风险

技术是公司最核心的竞争力，公司虽在 300mm 硅片相关的制造技术掌握成度达到了国内领先水平，MEMS 用抛光片和 SOI 硅片相关技术达到国际先进水平。但与国际前五大硅片制造企业在产品认证数量、技术与市场积累、成本控制等方面相比仍有一定差距，当前公司正处于逐步缩小与国际先进企业技术代差的进程之中。

半导体硅片行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。随着全球芯片制造技术的不断演进，对半导体硅片的技术指标要求也在不断提高，在产品研发和技术发展的趋势中，不进则退。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术未能持续创新，可能导致公司与国际先进企业的差距再次扩大，对公司的经营业绩造成不利影响。

#### （三）市场竞争加剧的风险

全球排名第三的台湾环球晶圆于 2020 年底发起了对排名第四的德国 Siltronic 的要约收购，报告期内，该并购案已通过了部分国家和地区的反垄断审查以及美国的 CFIUS 审查等，还有待其他部分国家和地区政府审查。若该交易最终成功达成，国际半导体硅片市场寡头垄断的格局将进一步加剧。

另一方面，近年来国内半导体硅片在产业政策和地方政府的推动下，新建项目不断涌现。伴随着全球芯片制造产能向我国转移的长期过程，国内市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场之一，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。因此，公司面临市场竞争加剧的风险，如不能有效利用好在国内的先发优势和国内市场的主场优势，将对未来的长期发展带来一定负面影响。

#### （四）新冠疫情影响的风险



新冠疫情虽持续延续，但公司及境内外子公司的生产经营情况正常，报告期内暂未因受到疫情影响发生减产或停产、销售发货延迟等情况。但随着德尔塔等变异病毒传染力增强和第三波疫情的发展影响，公司生产经营面临一定的或有风险。公司将在生产经营中加强防疫措施，尽量避免该等意外事件。

## 五、重大违规事项

无。

## 六、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年上半年，公司主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度（%）
营业收入	112,285.22	85,427.37	31.44
归属于上市公司股东的净利润	10,529.16	-8,259.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,652.63	-15,269.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,514.91	2,736.44	101.54
主要财务数据	2021年6月30日	2020年12月31日	增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	999,093.78	944,304.00	5.80
总资产	1,521,198.56	1,449,850.73	4.92

2021年上半年，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.042	-0.039	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.042	-0.039	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.031	-0.072	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.09	-1.35	增加2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.79	-2.49	增加1.70个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.75	7.58	减少2.83个百分点

上述主要财务数据和财务指标的变动原因如下：

1、2021年1-6月，公司营业收入为112,285.22万元，较上年同期营业收入85,427.37万元增长31.44%；归属于母公司股东净利润为10,529.16万元，上年同

期为-8,259.42 万元，较上年同期增加 18,788.58 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-7,652.63 万元，较上年同期-15,269.96 万元增加 7,617.33 万元。营业收入的增长，主要系因半导体市场需求旺盛及公司产能攀升，产量大幅增加所致，公司 200mm 及 300mm 硅片业务收入均有所增长。公司盈利增加主要是由于公司 200mm 及 300mm 产品出货量具有大幅增加，且产品毛利率均有所提升。

2、2021 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 5,514.91 万元，较上年同期 2,736.44 万元增长 101.54%，主要是由于公司报告期内营业收入增加带来的现金流入增加所致。

3、2021 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 1,521,198.56 万元，较 2020 年底资产总额 1,449,850.73 万元增长 4.92%；归属于上市公司股东的净资产为 999,093.78 万元，较 2020 年底归属于上市公司股东的净资产 944,304.00 万元增长 5.80%。

## 七、核心竞争力的变化情况

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。

### （一）产品组合优势

公司旨在成为“一站式”硅材料综合服务商，经过多年发展，已形成了以 300mm 硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以 SOI 硅片为核心的特色硅材料平台，产品尺寸涵盖 300mm、200mm、150mm，产品类别涵盖抛光片、外延片、SOI 硅片，并且布局了硅基绝缘体上压电薄膜材料等其他半导体材料。公司在半导体衬底材料方面的布局全面，能兼顾不同技术路线，覆盖更大范围的下游应用。

### （二）技术和研发优势

公司掌握了拉晶、抛光片、外延片、SOI 硅片生产的全套工艺，总体技术水平国内领先，部分技术水平达到国际先进水平。公司先后实现 SOI 硅片和 300mm 大硅片从无到有、从零到一的突破后，继续提升技术水平、扩大产品种类、拓展产品应用的广度。



截至报告期末，公司累计承担了 7 项国家级重大专项项目，在完成重大项目的同时，公司技术水平和生产能力持续提高，公司的技术积累为下一步继续突破更先进技术节点的研发和产业化打下良好的基础。

### （三）管理团队与人才优势

公司高度重视人才团队建设，自设立以来持续引进全球半导体硅片行业的高端人才，目前已形成由行业领军人才带领、以行业高端人才和资深人才为主构成的国内一流、成建制化、国际化、专业化的管理和技术研发团队。

### （四）客户优势

芯片制造企业对各类原材料的质量有着严苛的要求，对供应商的选择非常慎重，进入芯片制造企业的供应商名单具有较高的壁垒。公司已拥有众多国内外知名客户，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业。公司已形成对国内主要客户的全覆盖。

### （五）国际化布局优势

半导体行业是一个全球化的行业，供应链遍布以美、欧、日、韩和中国（含台湾地区）为主的全球各地。公司子公司 Okmetic 主要生产经营地在欧洲，子公司新傲科技、上海新昇、新硅聚合主要生产经营地在中国大陆，公司参股子公司法国 Soitec 是全球最重要的 SOI 硅片供应商。公司的供应链和销售渠道遍布全球，已成为国内半导体行业国际化较高的企业之一。

如上所述，2021 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 八、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化情况

公司持续推进国家重大科研项目及公司自研项目的研发工作，并在报告期内完成《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》项目的结题。2021 年上半年研发支出 5,330.35 万元，研发投入总额占营业收入比例为 4.75%，较上年同期 7.58%降低 2.83 个百分点。研发支出减少主要系公司 300mm 大硅片部分研发项目结题且新一期的项目正在立项过程中所致。但公司研发支出投入仍保持在较高水平。

### （二）研发进展

报告期内，除公司承担的《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》项目顺利完成国家“02 专项”验收外，《300mm 无缺陷硅片研发与先进制造》等重大项目的研发和产业化进度也进展顺利。

产品认证方面，公司可供应的产品规格数量进一步增加、公司产品可应用的工艺制程先进程度进一步提高。并且随着市场供需关系的转变和供应缺口的进一步扩大，同时伴随公司技术水平的积累和提升，公司产品认证的周期开始呈缩短趋势，有利于加快公司产品在下游客户的快速导入和放量。

公司已在技术上实现 300mm 硅片 14nm 及以上逻辑工艺与 3D 存储工艺的全覆盖和规模化销售、在客户上实现国内主要芯片制造厂商的全覆盖、在下游应用上实现了逻辑芯片/CIS 芯片/射频芯片以及包括 DRAM、3D-NAND、NOR Flash 在内的存储芯片的全覆盖，解决了国内 300mm 大硅片供应的“卡脖子”问题。报告期内，在这三个“全覆盖”的基础上，公司的研发能力持续提高，产品认证继续推进，产能和出货量进一步增加，提高了国内大硅片的自主可控供应能力。

#### 九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 十、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的证监许可[2020]430 号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海硅产业集团股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 620,068,200 股，每股发行价格为人民币 3.89 元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币 2,412,065,298.00 元，扣除发行费用人民币 127,675,510.47 元（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币 2,284,389,787.53 元，上述募集资金于 2020 年 4 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0303 号验资报告。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 34,426.02 万元，累计已使用募集资金金额为人民币 193,594.83 万元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 540.22 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净



额为 2,015.87 万元，募集资金余额为人民币 36,860.02 万元，其中用于现金管理金额为 0 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 36,860.02 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额（万元）
<b>2020 年 12 月 31 日 募集资金专户余额</b>	<b>50,335.82</b>
减：本年度直接投入募投项目	34,426.02
购买现金管理产品	30,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	540.22
赎回现金管理产品	50,410.00
<b>2021 年 6 月 30 日 募集资金专户余额</b>	<b>36,860.02</b>

公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司无控股股东和实际控制人。公司前两大股东上海国盛（集团）有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司分别持有公司 567,000,000 股股份，持股比例均为 22.86%。2021 年上半年，公司上述股东持股数未发生增减变动。截至 2021 年 6 月 30 日，上述股东持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

公司董事、监事、高级管理人员未直接或间接持有公司股份。

#### 十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司  
2021年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张博文



曹岳承



海通证券股份有限公司

2021年 8月 27日